



PASO A PASO

| *kapping dip powder system*

1

Realizamos los pasos normales de preparación de la superficie y colocamos BOND sobre toda la uña sin tocar cutículas.



2

Colocamos BASE cubriendo toda la uña.



3

Sumergimos directamente la uña en el CLEAR POWDER y removemos el polvo excedente con una brocha.



4

Repetimos PASO 2 y PASO 3.

5

Colocamos ACTIVATOR y dejamos secar.



6

Limamos bordes libres y pasamos Buffer sobre toda la uña para eliminar imperfecciones. Removemos el polvo excedente.



7

Una vez finalizado, podés continuar con el sistema que prefieras.